



台積公司頒發2020年度開放創新平台合作夥伴獎項

表揚優秀夥伴加速半導體創新的傑出表現

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2020年10月20日

台積公司今（20）日頒發 2020 年度開放創新平台（Open Innovation Platform[®], OIP）合作夥伴獎項，感謝 10 家矽智財、電子設計自動化、以及雲端聯盟合作夥伴的卓越成果。台積公司年度 OIP 合作夥伴獎項表彰過去一年來 OIP 生態系統夥伴在實現下一代系統單晶片（SoC）及三維積體電路（3DIC）設計方面所做的傑出貢獻。作為協助晶片設計人員實現創新及縮短產品上市時程的關鍵力量，生態系統夥伴們與台積公司緊密合作，協助客戶降低設計門檻，並獲取首次投片即成功。

台積公司研究發展及技術發展資深副總經理米玉傑博士表示：「台積公司感謝每一位合作夥伴的持續支持與合作，協助我們的客戶釋放半導體創新，並且將產品快速導入市場。他們的戮力付出開創了生氣蓬勃的設計生態系統，支援台積公司最新的技術，讓客戶可以更容易地獲取最先進的專業積體電路製造服務解決方案。在此恭喜 2020 年度台積公司 OIP 合作夥伴獎的所有得獎者，並且期待未來能夠持續合作，協助客戶解決設計的挑戰，開發功耗、效能與面積（PPA）的最佳化設計平台來支援智慧型手機、高效能運算、車用電子、以及物聯網應用。」

台積公司重視每一位生態系統合作夥伴，與其攜手提供採用台積公司最新技術並通過認證之解決方案與服務，以實現下一代 SoC 及 3DIC 設計。榮獲 OIP 年度合作夥伴獎項的公司在設計、開發、以及技術實作方面皆達到最高的標準，加速了半導體的創新。

台積公司 2020 年度 OIP 合作夥伴得獎名單如下：

矽智財聯盟得獎夥伴

- 類比與混合訊號矽智財: Silicon Creations
- DSP 矽智財: 益華電腦
- 嵌入式記憶體矽智財: eMemory Technology Inc.
- 高速 SerDes 矽智財: Alphawave IP
- 介面矽智財: 新思科技
- 處理器矽智財: 安謀國際
- 特殊製程矽智財: M31 Technology



電子設計自動化聯盟得獎夥伴

- 共同開發 3 奈米設計架構
 - ANSYS
 - 益華電腦
 - Mentor
 - 新思科技
- 共同開發 3DIC 設計生產解決方案
 - ANSYS
 - 益華電腦
 - Mentor
 - 新思科技

雲端聯盟得獎夥伴

- 共同開發雲端時序簽核設計解決方案
 - 益華電腦
 - 微軟
 - 新思科技

關於台積公司開放創新平台 (OIP)

台積公司開放創新平台 (OIP) 匯集客戶與夥伴的創新思考，秉持縮短設計時間、縮短量產時程、加速產品上市時間並加快獲利時程之共同目標。開放創新平台涵蓋半導體產業最完備的設計生態系統聯盟，集結包括業界領先的電子設計自動化、資料庫、矽智財、雲端、以及設計服務夥伴。台積公司擁有超過 20 年與生態系統夥伴合作的豐富經驗，並持續將矽智財與資料庫組合擴增至超過 2 萬 8,000 個項目。目前在 TSMC-Online 線上提供自 0.5 微米至 5 奈米超過 1 萬 2,000 個技術檔案及超過 450 個製程設計套件。

關於台積公司

台積公司成立於1987年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2019年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等272種製程技術，為499個客戶生產1萬761種不同產品。台積公司為世界首家提供5奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站<https://www.tsmc.com.tw>查詢。



#

台積公司發言人：
黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：
高孟華
公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 7125036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

孔培德
公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5031
Mobile: 0988-931-352
E-Mail: pdkramer@tsmc.com